

# JS-E-15X

「塗布性」「濡れ性」を追求した高濡れポストフラックス

## 高性能・高濡れポストフラックス

### ムラの無い噴霧でくまなく酸化膜除去

JS-E-15Xは基板各部分への馴染みがよく、フラックス塗布時の塗布ムラが起きにくく、フラックス膜を均一に形成、溶剤乾燥までに酸化物をくまなく除去でき、且つ、予熱途中での再酸化も抑制します。

### 良好なスルーホール上がり性

予熱段階での酸化膜除去・再酸化防止と、溶融はんだ接触時の良好な残渣流動性・各種金属表面への親和性、および、活性作用の最適化の結果、良好なスルーホール上がり性が得られます。

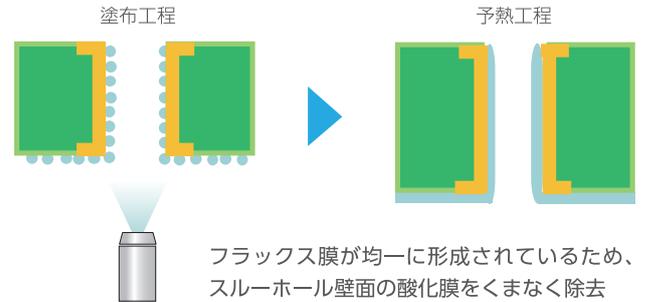
### 各種母材への濡れ性を向上

ニッケル、真鍮といった濡れの悪い材質に対しても予熱無し、且つ、比較的到低いはんだ温度でも、良好な濡れ性が得られます。局所はんだ付け用途にも最適です。

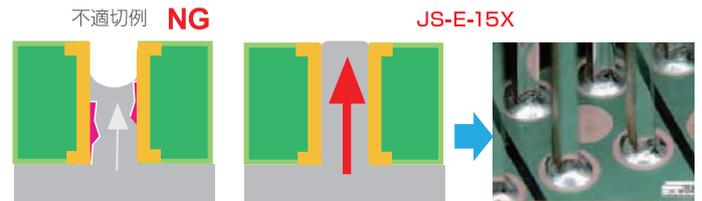
### 製品物性表

製品名	JS-E-15X
固形分含有量 (%)	14.8
比重 (at20℃)	0.822
ハライド含有量 (%)	0.089
フラックスタイプ	ROM1
適用塗布方法	スプレー/発泡
使用用途	フローはんだ付け

### ■ フラックス挙動イメージ (JS-E-15X)



### ■ スルーホールアップ挙動イメージ

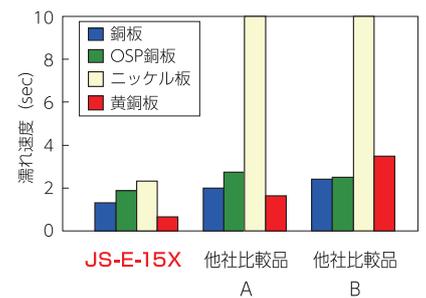


酸化物が残る部分は、スルーホール壁面に酸化物が無く、速やかな濡れ上  
濡れ上がり速度が遅い。 濡れ上がり速度が遅い。 濡れ上がり速度が遅い。  
濡れ上がり速度が遅い。 濡れ上がり速度が遅い。 濡れ上がり速度が遅い。

### ■ メニスコグラフ試験

#### 試験条件

- 試験片処理  
85℃85%RH×24h  
処理後、常温3h
- 測定条件  
装置：SAT-5000  
(レスカ製)
- 塗布：浸漬 (深さ2mm)
- 予熱：無し
- はんだ温度：245℃  
(Pbフリー)
- 浸漬速度：5 mm/s
- 浸漬深さ：2 mm
- 浸漬時間：10 sec



優れたスルーホールアップ

ブリッジ抑制

ハンダボール抑制

無洗浄タイプ

高濡れ

部分ディップ対応

対応 Sn/Ag/Cu系合金 Sn/Cu系

No-clean